

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕3-87 号

中微半导体（深圳）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称中微半导体公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中微半导体公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中微半导体公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中微半导体公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中微半导体公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中微半导体公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了中微半导体公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月十日

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，发行价为每股人民币30.86元，共计募集资金194,418.00万元，坐扣承销和保荐费用10,409.26万元（其中，不含税承销费为人民币98,200,566.04元，该部分属于发行费用，税款为人民币5,892,033.96元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为184,008.74万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元后，公司本次募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	181,650.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,347.23

项 目		序号	金 额
	超募资金永久补流	B2	64,000.00
	超募资金回购股份	B3	1,945.00
	利息收入净额	B4	4,345.07
本期发生额	项目投入	C1	11,915.74
	超募资金永久补流	C2	32,000.00
	超募资金回购股份	C3	1,100.00
	利息收入净额	C4	2,058.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,262.97
	超募资金永久补流	D2=B2+C2	96,000.00
	超募资金回购股份	D3=B3+C3	3,045.00
	利息收入净额	D4=B4+C4	6,403.51
应结余募集资金		E=A-D1-D2-D3+D4	56,745.63
实际结余募集资金		F	56,810.57
差异		G=E-F	-64.94

注：差异 64.94 万元构成：实际结余募集资金中 64.94 万元，系以公司自筹资金支付的发行费用

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中微半导体（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月20日分别与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行和招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年9月23日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支

行、中国工商银行股份有限公司深圳华联支行、中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和四川中微芯成科技有限公司（系中微半导体全资子公司，以下简称“四川中微芯成”）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年10月10日、2022年11月23日分别与交通银行股份有限公司深圳学府支行和中信银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司和四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年8月10日分别与中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年7月5日分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金账户、4 个大额存单账户和 4 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司深圳南山支行	41014100040050868	6,025,379.78	
招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755903282610616	50,648,253.32	
招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755903282610616	39,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000209688380	26,291.45	
中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629221883806	50,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629221883806	245,908.34	
中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行	757576189722	5,234.81	
中国民生银行股份有限公司桃园支行	682998899	817,877.69	
中国民生银行股份有限公司桃园支行	682998899	20,000,000.00	结构性存款
兴业银行深圳高新区支行	337130100100477025	2,316,201.16	
中信银行股份有限公司深圳后海支行	8110301012800642317	50,922.91	
中信银行股份有限公司深圳后海支行	8110301012800642317	130,000,000.00	大额存单

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450013006292252	96,921.52	
交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450013006292252	50,000,000.00	结构性存款
中国民生银行股份有限公司桃园支行	688886696	7,837,984.74	
中国民生银行股份有限公司桃园支行	688886696	140,000,000.00	大额存单
浦发银行深圳西乡支行	79460078801900001002	570.02	
中国民生银行股份有限公司桃园支行	656558899	11,034,188.89	
中国民生银行股份有限公司桃园支行	656558899	20,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司桃园支行	656558899	40,000,000.00	结构性存款
合 计		568,105,734.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的募集资金款项共计人民币 32,262.97 万元，募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2024 年 8 月 8 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品余额为 48,900.00 万元。

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日
1	中信银行	大额存单	固定收益	3,000.00	2023/1/5	2025/4/7
2	中信银行	大额存单	固定收益	5,000.00	2023/1/6	2026/1/6
3	中信银行	大额存单	固定收益	5,000.00	2023/1/5	2025/4/7
4	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2023/11/20	2025/7/20
5	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/1/20
6	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/2/20
7	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/2/20
8	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/2/20
9	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/6/20
10	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/3/20	2025/6/20
11	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
12	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
13	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
14	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
15	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
16	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
17	民生银行	大额存单	固定收益	1,000.00	2024/4/19	2027/4/19
18	交通银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024/10/21	2025/4/23
19	民生银行 8899	大额存单	固定收益	2,000.00	2024/12/10	2027/12/10
20	民生银行 8899	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024/12/13	2025/3/13
21	工商银行	大额存单	固定收益	5,000.00	2024/5/24	2027/5/24
22	民生银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024/12/6	2025/1/13
23	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	3,900.00	2024/12/11	2025/3/11

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过 30.86 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 7 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,506,639 股，占公司总股本的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 24.77 元/股，最低价为 16.35 元/股，回购均价为 20.21 元/股，使用资金总额为 30,447,268.11 元（不含交易佣金等交易费用），剩余资金留存在证券回购股份专用账户中。

附件： 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：中微半导体（深圳）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				181,650.09		本年度投入募集资金总额					45,015.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					131,307.97	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目	否	19,356.49	19,356.49	19,356.49	4,305.15	6,258.61	-13,097.88	32.33%	2026年3月	不适用	不适用	否
物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目	否	13,253.32	13,253.32	13,253.32	4,123.69	6,245.96	-7,007.36	47.13%	2026年3月	不适用	不适用	否
车规级芯片研发项目	否	28,275.05	28,275.05	28,275.05	3,486.90	7,758.40	-20,516.65	27.44%	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00		100.00%		不适用	不适用	否
项目小计	—	72,884.86	72,884.86	72,884.86	11,915.74	32,262.97	-40,621.89	—	—		—	—

超募资金投向												
超募资金					33,100.00	99,045.00						
其中：永久补充流动资金	否	—	—	—	32,000.00	96,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	—	—	—	1,100.00	3,045.00		不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计					33,100.00	99,045.00						
合计	—	—	—	—	45,015.74	131,307.97		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期并增加实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并增加公司或全资子公司为实施主体。大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目及车规级芯片研发项目预定可使用状态日期由 2024 年 3 月调整至 2026 年 3 月。本次募投项目延期并增加实施主体的原因为：上述募投项目均由若干子项目构成，而后续子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行。各子项目成熟一个可以使用一个，分批投产使项目具有更高经济效益，项目延期符合募投项目研发的客观实际、公司整体利益和长远发展；公司拥有多个研发团队，多数研发项目需要各团队配合进行，增加募投项目实施主体有利于公司研发资源整合，提高研发效率，加快募投项目推进速度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 6,471.13 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2022 年 8 月 16 日公司发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 170,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品 117,356.49 万元。 2023 年 8 月 12 日公司发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，经第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品 98,000 万元。 公司 2024 年 8 月 8 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金进行现金管理或投资相关产品 48,900 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 9 月 9 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。公司于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	详见一、（二）募集资金使用和结余情况中说明

募集资金其他使用情况	公司 2024 年大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目、物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目、车规级芯片研发项目，“研发费用”投入中，包括委托其他全资子公司进行研发的相关支出。 2024 年 8 月 28 日公司发布了《关于调整募投项目内部投资结构的公告》，经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目”、“物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目”、“车规级芯片研发项目”的内部投资结构。
------------	---